

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年11月13日)

编号：2024-014

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	长江证券、鹏华基金、中银基金、德邦基金
时间	2024年11月13日
地点	灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士 证券事务代表：钱志红女士
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 第二部分：问答环节 1、问：公司的主营业务是什么，有哪些应用领域？ 答：公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来，依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累，始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案，不断提升企业的品牌与价值。谢谢。 2、问：公司的产品能用在5.5G基站上吗？ 答：公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5G-A/5.5G等各类架构通信网

络。公司将持续跟踪 5G-A/5.5G、6G 技术发展动态，做好相关的预研及技术储备，与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展，积极参与客户的解决方案。谢谢。

3、问：公司的产品有用到卫星上吗？

答：公司的产品有应用于星网计划，公司长期以来参与国防科工领域重点工程，公司将与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展。谢谢。

4、问：公司未来具体的发展计划有哪些？

答：1、创建一流的电子陶瓷材料研发平台

电子陶瓷材料作为核心基础原材料，是实现各种电子元器件的基础，也是实现公司战略目标的关键。作为基础材料，电子陶瓷材料在介电特性、损耗特性、热力学特性等方面是电子元器件的发展核心，其重要性对电子元器件不言而喻。经过几十年的发展，各种新型电子陶瓷材料和新型应用层出不穷。随着 5G 建设大规模开展及万物互联时代的到来，各种新应用对电子设备的性能、能耗、可靠性、成本提出了越来越高的要求，也给电子陶瓷材料的发展和壮大提供了广阔的舞台。电子陶瓷材料的开发，将是材料学科的下一个蓝海。

在电子陶瓷材料领域，一方面，公司将在现有基础上不断完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑超低频、超高频射频介质滤波器、天线等产品的应用。另一方面，公司将依托现有的陶瓷材料研发体系及经验，拓展电子陶瓷材料应用的新领域，着力开发一批 HTCC 陶瓷、LTCC 陶瓷、高强度介质陶瓷、热管理陶瓷、储能陶瓷、复合陶瓷材料等先进陶瓷材料。在电子陶瓷先进工艺领域，公司将加大投入并着力打造面向未来的，全体系的电子陶瓷先进工艺技术平台，涵盖陶瓷材料制备、陶瓷体加工、陶瓷金属化及表面处理、陶瓷组装等工艺领域，为电子陶瓷的广泛应用打下坚实的基础。

2、巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位

随着基站用陶瓷滤波器的市场需求不断增长，公司目前已成为国内外主要通信设备制造商的重要供应商。面对通信产业以介质滤波器为代表的各类陶瓷射频元件的市场需求，公司拟加大投入力度，进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院等。

在介质滤波器、介质谐振器、介质天线等射频器件方面，依托公司积累的设计制造经验和广泛的客户认可度，大力推广该类产品的市场应用，完善公司在移动通信市场的布局，成为射频元器件无源器件的综合供应商。

3、拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场

电子陶瓷作为功能陶瓷领域的一个重要分支，在现代通讯、

半导体、电力电子、交通运输、航空航天等领域已有广泛应用，并形成了一批起源于日本、美国等的电子陶瓷头部企业。随着这些产业的半导体技术、新能源技术、AI 等核心技术的快速发展，电子陶瓷的应用领域将进一步拓宽，为人类社会发展作出更加巨大的贡献。公司将对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场，深度拓展电子陶瓷新应用。

在新能源、半导体、万物互联等领域，公司将依托先进电子陶瓷材料、全系列电子陶瓷加工工艺等平台，发挥积累多年的电子陶瓷元器件的设计制造经验，研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品，涵盖陶瓷封装、陶瓷基板、陶瓷热沉、复合陶瓷、LTCC 器件、介质陶瓷元器件等一系列产品及解决方案，以满足新能源、半导体、万物互联等产业的发展需求。谢谢。

5、问：公司 HTCC 产品的进展情况？

答：公司目前已建成完整的 HTCC 自动化设备产线，建立了 HTCC 产品线端到端的能力。从产品设计、陶瓷材料制备、瓷体成型、烧结、表面金属化、钎焊组装、测试检验、试验分析等可全部由公司内部完成。在 HTCC 陶瓷材料领域，根据不同应用场景，公司已开发出 92/95/96/99 氧化铝等成熟配方 8 种，并着手于高导热氮化铝、氮化硅陶瓷材料研发。在 HTCC 制造工艺领域，公司已实现单层厚度最小 0.1mm，最小孔径 0.1mm，最小线宽 50um，最小线距 50um 的极限工艺能力，适用于高精度 HTCC 产品制造。在 HTCC 封装产品形态方面，公司已完成微波 SIP、微波功率管壳、CMOS、光通信、光耦合器封装、CPGA、CBGA、CQFN、CLCC、CSOP、CQFP 等系列封装产品的开发和送样；其中微波 SIP 等产品已取得客户认可，开始小批量交付使用。在陶瓷基板产品形态领域，公司数款 DPC 陶瓷基板已完成小批量交付验证。

公司控股子公司频普半导体目前已具备薄膜电路及相关薄膜 MEMS 无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产，目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板，已经开始批量生产。

控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C 终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得了阶段性进展。谢谢。

6、问：公司的新产品应用在半导体哪些领域？目前用于半导体领域的产品订单情况怎么样？

答：公司的 HTCC 电子陶瓷产品主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端，包括汽车电子、计算机、远程医疗、智能家居、高频通讯等。公司订单情况良好，

	具体情况请参见公司后续定期报告。公司将根据市场需求情况与客户保持密切的互动，与客户技术发展保持同步。谢谢。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月15日